【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成19年7月19日(2007.7.19)

【公開番号】特開2005-353669(P2005-353669A)
【公開日】平成17年12月22日(2005.12.22)
【年通号数】公開・登録公報2005-050
【出願番号】特願2004-169981(P2004-169981)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/60　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　21/92　　６０４Ｆ
Ｈ０１Ｌ　21/60　　３１１Ｑ

【手続補正書】
【提出日】平成19年5月31日(2007.5.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
表面に形成された溝にバンプとなる塑性変形する材料が充填された第１の基板と、表面に密着層を介して塑性変形する材料を含むパッドが設けられた第２の基板と、を用意する工程と、
前記第１の基板の前記表面と前記第２の基板の前記表面とを対向させ重なり合わせ、前記第１及び第２の基板に荷重を印加することによって、前記バンプとなる塑性変形する材料と前記パットとを接合する工程と、
前記第１の基板と前記第２の基板を引き剥がすことによって、前記第２の基板に前記バンプとなる塑性変形する材料を転写する工程と、を備えるバンプを有する基板の製造方法。
【請求項２】
前記塑性変形する材料が、少なくともＡｕ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｓｎの何れかである請求項１記載の製造方法。
【請求項３】
前記第１の基板及び前記第２の基板がＳｉから構成され、前記密着層が、Ｃｒ又はＴｉから構成されていることを特徴とする請求項１記載のバンプを有する基板の製造方法。